

Okamoto

SEMICON[®] セミコンジャパン2012のご案内 Japan2012

2012年12月5日(水)～7日(金) / 幕張メッセ

Booth Number

4A-305

拝啓

貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、今年も幕張メッセにてセミコンジャパン2012が開催されます。

弊社は近年注目が集まるTSVプロセス、グリーンデバイス用難削材、太陽光発電用の加工装置技術、MEMS及びパッケージ加工技術の紹介をいたします。ご多忙中誠に恐縮ではございますが、弊社小間にご来場賜ります様お願い申し上げます。

敬具

平成24年11月吉日

株式会社 岡本工作機械製作所

代表取締役社長 西本 實男

出 展 内 容

TSV用加工 TSVプロセスへの取り組みと開発装置の紹介

薄厚化技術 インラインバックグラインダーGDM300 25um量産加工対応

グリーンデバイス加工 サファイア、GaN 及び SiC 向け加工機及びプロセスの提案

太陽光発電用加工 全自動Siインゴット加工装置及びプロセスの提案

特殊材料加工技術 ガラス、樹脂、セラミック等の特殊材料加工技術

岡本工作機械

<http://www.okamoto.co.jp>

Okamoto

SEMICON[®] SEMICON JAPAN 2012 Information Japan 2012

December 5—7 / Makuhari Messe, Japan

Booth Number

4A-305

To All Our Valued Customers.
Hope you are doing well.

We are participating in Semicon Japan 2012 at Makuhari Messe, Tokyo.

We will be introducing the following at this Show:

1. TSV process and Machine
2. Green devices
3. Grinding of Exotic material
4. Solar panel processing machine
5. MEMS and packages processing

All of us at Okamoto look forward to your visit.

BEST REGARDS

November 2012

OKAMOTO Machine tool works, LTD.

Chairman Nishimoto Jitsuo

Exhibit

TSV Process Introduce TSV process and development machine.

Thinning process Production In-line back grinder GDM300 25um.

Green devices process Proposal Sapphire and SiC, process and machine

Solar panel process Proposal Fully auto Si ingot production machine and process

Special material process Proposal Glass, Resin, Ceramics, Special material process technology

Okamoto

<http://www.okamoto.co.jp>